

W-GM-4200

Wafer Edge Grinding Machine

- ベストセラー機 W-GM シリーズ
- コンパクトな設計でスペース効率アップ
- X 軸・Y 軸・ θ 軸の同期補完制御による高精度な研削
- タッチパネルによる簡単操作
- 研削結果の測定と自動補正が可能



W-GM-4200 仕様

基本仕様		
ウェーハサイズ	$\phi 2'' \sim \phi 6'' / \phi 4'' \sim \phi 8''$	
ウェーハの厚み	0.4 ~ 1.0mm (標準)	
ウェーハの形状	OF、CF × 2 (<1/2 OF) / ノッチ (オプション)	
研削部	2 ステージ	
外周加工用砥石形状	砥石溝径	$\phi 200\text{mm}$
	砥石外径	$\phi 202\text{mm}$
	内径	$\phi 30\text{mm}$
	フランジ厚み	20mm
外周スピンドル回転数 ($\phi 202$) 時	4000rpm	
研削スピード	外周部、オリフラ部、ノッチ部で個別に設定可能	
外周加工用スピンドル	$\phi 5'' \sim \phi 8''$: ビルトインモータ方式 $\phi 2'' \sim \phi 6''$: ベルトドライブ方式	
操作パネル	12" カラー LCD タッチパネル	
シグナルタワー	3 色表示灯	
装置寸法	2115 (W) x 1410 (D) x 2000 (H) mm	
装置重量	約 3000kg	
機構部仕様		
研削テーブル X, Y, Z 軸	分解能	1 μm
研削テーブル θ 軸	分解能	0.001°
	駆動方式	AC サーボモータ 他
トランスファ部	搬送方式	吸着搬送 (上面)
洗浄部	洗浄方式	スピン洗浄
	乾燥方式	ドライエアー
供給部・収納部	方式	カセットキャリア
	カセット数	4 カセット
測定部仕様		
ウェーハ厚さ測定	分解能	1 μm
	繰り返し測定精度	$\pm 2 \mu\text{m}$ 以内
	測定方法	非接触式または接触式
	測定機	接触式 : 東京精密製 ミニアックス (モアレスケール) 非接触式 : 東京精密製 キャディコム (静電容量センサ)
非接触式 アライメント機構	方式	レーザー方式
	分解能	1 μm
	センタリング精度	$\pm 50 \mu\text{m}$ 以内

